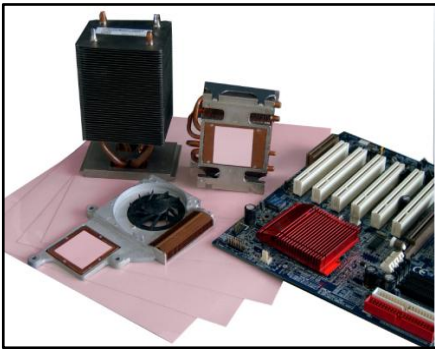


导热相变片

【产品概述】

SP205P 是一种在 50-65°C 已经开始软化的相变材料。液态时比传统的导热填充垫更能有效地填充及覆盖接触界面之间的缝隙和坑洼。另一方面，SP205P 在室温环境下是固体形态，为组装及使用提供操作上的便利。

【产品图示】



特性参数 SP205P		
项目	检测	测试方法
颜色	粉红色	目视
厚度	0.005" (0.127mm)	ASTM D751
厚度公差	±0.0006" ±0.016mm)	ASTM D751
密度 (g/cc)	1.8	ASTM D297
适用温度	-40°C ~ 125°C	***
相变化温度	50°C ~ 65°C	***
体积电阻 (Ω . cm)	2.0 X 10 ¹³	ASTM D257
导热系数 (W/m.k)	2.5	ASTM D5470
介电常数(1M HZ)	3	ASTM D150
热阻抗@50psi/@10psi (°C*in ² /W)	0.5	ASTM D5470
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：厚度公差为±10%，硬度公差为±5°，颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。

【特点与优势】

- 2.50W/m.k 导热系数
- 在 50° ~60° 发生相变
- 常温下自带一定粘性
- 无需预热操作

【典型应用】

- 高频微处理器
- 手提或台式电脑
- 计算机服务器
- 存储器
- 集成芯片
- LED 照明产品

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输。

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 本产品有效期为 12 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据表 (MSDS) 》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。